



意法半導體公布2025年第一季財報

- 第一季營收達 **25.2** 億美元；毛利率 **33.4%**；營業利益 **300** 萬美元；淨利 **5,600** 萬美元
- 財測中位數預估第二季營收 **27.1** 億美元，毛利率 **33.4%**
- 公司推動的重整製造佈局及調整全球成本結構的計畫進展順利，至 **2027** 年底可達成每年高達數億美元的成本節省目標

【臺北訊，2025年4月29日】— 服務橫跨多重電子應用領域之全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）公布截至2025年3月29日止，依據美國會計準則（U.S. GAAP）編製的第一季財報。

意法半導體2025年第一季營收達25.2億美元，毛利率為33.4%，營業利益為300萬美元，淨利為5,600萬美元，稀釋後每股盈餘為6美分。

意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 表示，「第一季淨營收落在財測中位數範圍內，個人電子產品營收成長帶動整體表現，但受汽車與工業領域營收低於預期影響；毛利率則因產品組合變化，略低於財測中位數。與去年同期相比，第一季淨營收年減27.3%，營業利益率由15.9%大幅下滑至0.1%，淨利亦大減89.1%，至5,600萬美元。本季，公司的訂單出貨比（book-to-bill ratio）有所改善，汽車與工業領域均回升至一以上。針對第二季，財測中位數預估營收為27.1億美元，年減16.2%，季增7.7%；毛利率預期約為33.4%，其中包含約420個基點的閒置產能成本影響。公司計畫將2025年淨資本支出（非U.S. GAAP¹）維持在20億至23億美元區間，以推動製造基地重整。儘管目前環境充滿不確定性，公司認為2025年第一季將是本波循環的低點，未來將專注於可掌控的領域，包括持續創新、強化產品與技術組合的競爭力、聚焦先進製造技術，以及嚴格控管成本。而公司推動的製造佈局重整及全球成本結構調整計畫進展順利，確認至2027年底可達到每年高達數億美元的成本節約目標。」

季度財務摘要

美國一般公認會計原則（U.S. GAAP） (單位：百萬美元，除每股數據外)	2025年 第一季	2024年 第四季	2024年 第一季	Q/Q	Y/Y
營收	\$2,517	\$3,321	\$3,465	-24.2%	-27.3%
毛利	\$841	\$1,253	\$1,444	-32.9%	-41.7%
毛利率	33.4%	37.7%	41.7%	-430 個基點	-830 個基點
營業利益	\$3	\$369	\$551	-99.2%	-99.5%
營業利益率	0.1%	11.1%	15.9%	-1,100 個基點	-1,580 個基點
淨利	\$56	\$341	\$513	-83.6%	-89.1%

¹ 本資料包含非U.S. GAAP財務指標。關於與U.S. GAAP財務數據之調節，以及公司認為此類指標具參考價值的相關說明，請參閱附錄。

稀釋後每股盈餘	\$0.06	\$0.37	\$0.54	-83.8%	-88.9%
---------	--------	--------	--------	--------	--------

2025年第一季財報摘要

意法半導體自 2025 年 1 月 1 日起對部門報告方式進行了調整，並已對前期比較數據做對應調整。詳情請參閱附錄。

各部門淨營收表現 ¹ (單位：百萬美元)	2025 年 第一季	2024 年 第四季	2024 年 第一季	Q/Q	Y/Y
類比產品、MEMS 與感測器 (AM&S) 部門	1,069	1,348	1,406	-20.7%	-23.9%
功率與離散元件 (P&D) 部門	397	602	631	-34.1%	-37.1%
小計：	1,466	1,950	2,037	-24.8%	-28.0%
嵌入式處理 (EMP) 部門	742	1,002	1,047	-26.0%	-29.1%
射頻與光通訊 (RF&OC) 部門	306	366	378	-16.5%	-19.2%
小計：	1,048	1,368	1,425	-23.4%	-26.5%
其他	3	3	3	-	-
營收總額	\$2,517	\$3,321	\$3,465	-24.2%	-27.3%

2025 年第一季營收達 25.2 億 美元，年減 27.3%。按客戶類型劃分，OEM 客戶淨銷售年減 25.7%，代理商銷售則年減 31.2%。與前一季相比，營收下滑 24.2%，不過表現仍優於公司財測中位數 20 個基點。

本季毛利為 8.41 億美元，較去年同期減少 41.7%；毛利率為 33.4%，較公司財測中位數低 40 個基點，並較去年同期下滑 830 個基點，主要受產品組合變化影響，另有部分來自閒置產能成本增加及售價下降的因素。

營業利益大幅下滑 99.5%，降至 300 萬美元，相較 2024 年第一季的 5.51 億美元顯著縮減。營業利益率亦降至營收的 0.1%，年減 1,580 個基點，前一年同期則為 15.9%。若排除資產減損、重整費用及其他相關淘汰成本，本季調整後營業利益為 1,100 萬美元。

各部門營收與財務表現概況：

類比、功率與離散元件、MEMS 與感測器 (APMS) 產品部門：

類比產品、MEMS 與感測器 (AM&S) 部門營收年減 23.9%，主要因類比產品需求下滑所致；營業利益下滑 66.7%，降至 8,200 萬美元，營業利益率為 7.7%，較去年同期的 17.5% 明顯下降。

功率與離散元件 (P&D) 部門營收年減 37.1%；營業表現由去年同期的 7,700 萬美元轉為虧損 2,800 萬美元，營業利益率為負 6.9%，而去年同期則為 12.1%。

微控制器、數位IC與射頻產品 (MDRF) 產品部門：

嵌入式處理 (EMP) 部門營收年減 29.1%，主要受通用類比與混合訊號產品 (GPAM) 產品需求下滑影響；營業利益減少 71.5%，降至 6,600 萬美元，營業利益率為 8.9%，低於去年同期的 22.2%。

射頻與光通訊 (RF&OC) 部門營收年減 19.2%；營業利益減少 59.0%，降至 4,300 萬美元，營業利益率為 13.9%，低於去

¹ 可報導部門之定義請參閱附錄。

年同期的 27.4%。

本季淨利降至 5,600 萬美元，稀釋後每股盈餘為 6 美分，較去年同期的 5.13 億美元及每股 54 美分明顯下滑。若排除資產減損、重整費用及其他相關淘汰成本（扣除相應稅負影響），2025 年第一季調整後淨利為 6,300 萬美元，稀釋後每股盈餘為 7 美分。

現金流量與資產負債表重點

(單位：百萬美元)	2025 年 第一季	2024 年 第四季	2024 年 第一季	近 12 個月		
				2025 年 第一季	2024 年 第一季	TTM 變動
營業活動現金流入（淨額）	574	681	859	2,680	5,531	- 51.5%
自由現金流 (Free cash flow，非 U.S. GAAP)	30	128	(134)	453	1,434	- 68.4%

2025 年第一季，營業活動現金流入（淨額）為 5.74 億美元，較去年同期的 8.59 億美元下滑。

同期淨資本支出（Net Capex，非 U.S. GAAP）為 5.30 億美元，低於去年同期的 9.67 億美元。

本季自由現金流（Free cash flow，非 U.S. GAAP）為正數，達到 3,000 萬美元，去年同期則為負 1.34 億美元。

2025 年第一季末庫存金額為 30.1 億美元，高於前一季的 27.9 億美元及去年同期的 26.9 億美元。期末庫存週轉天數為 167 天，相較前一季及去年同期的 122 天均有所上升。

第一季，公司向股東支付現金股利總額 7,200 萬美元，並依現行庫藏股回購計畫，執行 9,200 萬美元的庫藏股回購。

截至 2025 年 3 月 29 日，意法半導體的淨財務狀況（非 U.S. GAAP）達 30.8 億美元，略低於 2024 年 12 月 31 日的 32.3 億美元，並反映出總流動資金 59.6 億美元及總財務負債 28.8 億美元。若考量尚未發生資本支出的資本補助款預收款項對總流動資金的影響，調整後淨財務狀況（非 U.S. GAAP）截至 2025 年 3 月 29 日則為 27.1 億美元。

公司發展動態

2025 年 4 月 10 日，意法半導體公布推動製造基地重整與全球成本結構的調整計畫，並確認至 2027 年底可達到每年數億美元的成本節省目標。公司亦進一步揭露全球製造基地重整計畫的相關內容。

未來展望

意法半導體針對 2025 年第二季的財測中位數預估如下：

- 營收預計達 27.1 億美元，較前一季成長 7.7%，誤差範圍為正負 350 個基點。
- 毛利率預期為 33.4%，誤差範圍為正負 200 個基點。
- 本預測係假設 2025 年第二季有效匯率約為 1 歐元兌 1.08 美元，並已納入現有避險合約的影響。
- 第二季將於 2025 年 6 月 28 日結束。

本次財測未納入全球貿易關稅未來可能進一步變動所帶來的影響，僅以目前情況為基礎進行預估。

補充性非美國會計準則財務資訊之使用

本新聞稿包含補充性非美國會計準則 (non-U.S. GAAP) 財務資訊。

請注意，此類財務指標未經審計，且未依照美國會計準則編製，不應作為美國會計準則財務指標之替代。此外，這些非美國會計準則財務指標可能無法與其他公司標題相同的財務資訊直接比較。為彌補此等限制，補充性非美國會計準則財務資訊不應單獨閱讀，而應結合意法半導體依照美國會計準則編製之合併財務報表一併參閱。

有關意法半導體非美國會計準則財務指標與其對應之美國會計準則財務指標的調節表，請參閱本新聞稿附錄。

前瞻性資訊

本新聞稿中部分非屬歷史事實之陳述，屬於對未來展望的聲明及其他前瞻性陳述（依據經修訂之《1933 年美國證券法》第 27A 條或《1934 年美國證券交易法》第 21E 條定義）。此類陳述係基於管理階層目前的觀點與假設，並受到已知及未知風險與不確定性之影響，可能導致實際結果、表現或事件與此等陳述所預期者有重大差異，主要因素包括但不限於：

- 全球貿易政策變化（包括關稅及貿易壁壘的施行與擴大），可能影響整體宏觀經濟環境，並對本公司產品需求產生不利影響；
- 宏觀經濟與產業趨勢的不確定性（如通膨、供應鏈波動），可能影響本公司生產能力及終端市場對產品的需求；
- 客戶需求與預測出現差異，導致公司需推動轉型措施，且此等措施未必能完全達成預期效益；
- 能否於技術快速變遷的環境中設計、製造及銷售創新產品；
- 本公司、客戶或供應商營運地區的經濟、社會、公共衛生、勞工、政治或基礎設施情況變動，包括因宏觀經濟或區域性事件、地緣政治及軍事衝突、社會動盪、勞工行動或恐怖活動所造成之影響；
- 出現未預期的事件或情勢，可能影響本公司執行計畫及／或達成研發與製造計畫目標之能力，尤其是依賴公共資金支援的專案；
- 主要經銷商財務困難或關鍵客戶大幅縮減採購量；
- 本公司生產設施的產能利用率、產品組合及製造表現，或履行與供應商或第三方製造服務商簽訂之產能預留合約的需求量；
- 設備、原物料、公用事業服務、第三方製造服務及技術或其他營運所需資源的可得性與成本（包括因通膨導致的成本上升）；
- 本公司資訊系統的功能與效能，該系統支援製造、財務及銷售等關鍵營運活動，惟可能面臨資安威脅，若本公司或客戶、供應商、合作夥伴及第三方授權技術提供者之資訊系統遭受入侵，將可能造成不利影響；
- 員工、客戶或其他第三方之個人資料遭竊取、遺失或濫用，以及違反資料隱私法規之風險；
- 競爭對手或其他第三方提出的智慧財產權主張，及本公司能否以合理條件取得所需授權；
- 稅制變動、新制定或修訂的法規、稅務稽核結果或國際租稅協定之變更，可能影響本公司整體稅務狀況、營運成果，及正確估算稅額抵減、優惠、扣除項目與提列準備金，或實現遞延所得稅資產的能力；
- 匯率市場波動，尤其美元兌歐元及其他主要營運貨幣之匯率變動影響；
- 現行訴訟案件之結果，以及未來可能涉及之新訴訟所帶來的影響；
- 有關本公司產品之產品責任或保固索賠、因產品流行性故障或交貨失誤而產生的索賠，或因客戶召回含有本公司零組件產品而引發的索賠；

- 天然災害事件，例如極端氣候、地震、海嘯、火山爆發或其他自然現象，以及氣候變遷影響、公共衛生風險與疫病或大流行，特別是在本公司、客戶或供應商營運所在地區；
- 產業相關法規與倡議趨嚴，包含氣候變遷與永續發展相關議題，及本公司目標，包括實現範疇一及範疇二（直接與間接排放）之碳中和、範疇三之產品運輸、商務差旅及員工通勤排放管理，以及在 2027 年底前達成 100% 使用再生能源電力的承諾；
- 疫病或大流行，可能對全球經濟造成長期且重大的負面衝擊，進而對本公司業務與營運成果產生重大不利影響；
- 因供應商、競爭對手及客戶進行垂直或水平整併而引發的產業變化；
- 本公司新產品計畫推展，若受限於本公司控制範圍外之因素，如關鍵第三方零組件可得性及分包商表現未符預期，可能影響導入進度；
- 個別客戶實際使用某些產品時，若用途或表現（例如能源消耗）與原先預期不同，可能導致無法達成本公司已公開揭露之減碳目標，並可能引發法律訴訟或增加額外研發支出。

這些前瞻性陳述涉及各種風險與不確定性，可能導致本公司實際業績與營運表現與前瞻性陳述中所述有重大不利差異。某些前瞻性陳述可透過前瞻性術語識別，例如「相信」、「預期」、「可能」、「預期將」、「應當」、「將會」、「尋求」等字詞，或類似表達、否定形式、其他變體，或透過探討策略、計畫或意圖而識別。

部分風險因素已列載於本公司截至 2024 年 12 月 31 日止之年度由美國證券交易委員會（SEC）提交之 20-F 表格年度報告中「第 3 項重要資訊 - 風險因素」章節，並有更詳細說明。若其中一項或多項風險或不確定性成真，或基礎假設被證明不正確，實際結果可能與本新聞稿中預期、相信或預估之結果產生重大差異。本公司無意，亦不承擔任何更新本新聞稿中所載行業資訊或前瞻性陳述以反映後續事件或情勢變化之義務。

若上述因素或本公司不時於向美國證券交易委員會（SEC）提交文件中「第 3 項重要資訊 - 風險因素」章節所列其他因素出現不利變動，均可能對本公司業務及 / 或財務狀況造成重大不利影響。

關於意法半導體

意法半導體擁有 50,000 名研發與製造專業人才，掌握完整的半導體供應鏈，並營運多座先進晶片製造廠。作為垂直整合製造商（IDM），我們與超過 20 萬家客戶及數千家合作夥伴緊密合作，開發創新產品、解決方案與生態系統，以回應市場需求並迎接產業挑戰，同時推動永續發展。我們的技術支援更智慧的交通應用、更高效的能源管理，以及大規模雲端連網自主裝置的應用。公司正積極邁向碳中和目標，涵蓋範疇 1 和範疇 2 的直接與間接排放，以及產品運輸、商務差旅與員工通勤的範疇 3 排放，並計劃在 2027 年底前全面採用 100% 再生能源。欲了解更多資訊，請造訪 www.st.com。